

供媒體立即發佈

投資者關係：

Ed Lockwood

投資者關係資深總監

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

媒體關係：

Meggan Powers

企業宣傳資深總監

(408) 875-8733

meggan.powers@kla-tencor.com

針對 KLA-TENCOR 的 28XX 缺陷檢測系統推出的新 XP 升級將提供更強的靈敏度、產能、缺陷良率相關性

【加州 Milpitas 2009 年 6 月 30 日訊】專為半導體和相關產業提供製程控制及良率管理解決方案的全球領先供應商 KLA-Tencor 公司（納斯達克股票代碼：KLAC）為 28XX 寬頻明場檢測系統發佈了一款新的升級套件 — XP。XP 升級套件是市面上第一款為檢測系統提供標準積體電路設計佈局檔案（讓光罩車間能夠形成光罩圖案的指令）的產品。得到此資訊後，檢測系統即可掌握電路內的缺陷位置，並更好地估算其影響產品良率的概率。此外，XP 能夠利用與設計結合的晶圓檢測結果，以識別在印刷電路時可能對製程變化特別敏感的光罩上的特征。XP 升級套件的這些及其他功能的設計目的在於提升現有 28XX 檢測機台的靈敏度與產能，並增加缺陷結果的資訊內容，此對於加速尋找與解決缺陷問題很有幫助。

KLA-Tencor 的晶圓檢測事業群 (Wafer Inspection Group) 副總裁兼總經理 Mike Kirk 博士表示：「在以消費者為導向的市場中，晶片複雜度與價格壓力不斷增加，我們的客戶正在尋求便於進行缺陷根源分析的工具，以提升產能並實現更快和更有效的達到穩定生產。如今，我們領先的晶圓廠必須運用讓 193nm 光刻能夠印制幾近十分之一光照波長線寬的特徵的先進光刻技術，目前這種線寬已經可以用可數的原子來度量。在此環境下，即使是一片晶圓上的最小缺陷或一個光罩上的介于臨界點的圖案也會產生巨大的良率影響。我們新的 XP 升級套件能滿足我們客戶對優化缺陷擷取，以及從無關或雜訊缺陷的海洋中找到系統性缺陷和其他與良率相關的缺陷的需求，這代表了一個巨大的進步。此外，XP 能夠以具有成本效益的方式提供這種有價值的能力：做為大多數領先晶圓廠中已有檢測系統的一個升級。」

新的 XP 升級套件包含專為改善檢測結果或檢測機台產能而設計的若干功能，其中包括：

- 基於缺陷位置的電路圖案的密度，在檢測期間對良率相關缺陷的優先擷取；
- 利用電路設計資訊並根據特定圖案組設定高度局部化的缺陷檢測閾值，對晶粒內所有關鍵區域的缺陷擷取進行優化。
- 可密切監測具有最小製程靈活度的圖案類型，實現對臨界點光刻狀況的早期偵測；以及
- 新製程層級或新裝置的衍生「配方」（對檢測具有決定性影響的光學、機械和演算法參數設定）的線下產生。做為若干配方快速化的功能之一，此功能可大幅減少配方設定所需的時間和勞力，藉此提升檢測機台的產能，並讓即使是對小批量或快速試製的裝置配方優化也切實可行。

XP 升級套件是針對已被廣泛採用的 281x 和 282x 明場檢測系統的一項升級，已出貨至多間晶圓代工廠、記憶體與邏輯電路生產廠，且在 20 多篇技術論文中都有專門論述。

KLA-Tencor 公司簡介：

KLA-Tencor Corporation (納斯達克股票代碼：KLAC) 是製程控制與良率管理解決方案的領先提供商，它與全球客戶合作，開發先進的檢測與度量技術。這些技術為半導體、資料儲存、化合物半導體、光電及其他相關奈米電子產業提供服務。公司擁有廣泛的業界標準產品系列及世界一流的工程師與科學家團隊，三十餘年來為客戶努力打造優秀的解決方案。KLA-Tencor 的總部設在美國加利福尼亞州米爾皮塔斯 (Milpitas)，並在全球各地設有專屬的客戶營運與服務中心。如需更多資訊，請參觀網站 www.kla-tencor.com。(KLAC-P)

前瞻性聲明：

本新聞稿中除歷史事實以外的聲明，例如關於向更小關鍵線寬及深亞波長光刻的預期技術轉移，解決有關此預期轉移挑戰的 XP 的能力，以及 XP 的預期效能（包括我們的客戶透過利用 XP 升級套件而可能實現的其缺陷擷取增強效能和優勢）等陳述，均為前瞻性聲明，並受到《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 規定的「安全港」(Safe Harbor) 條款的制約。這些前瞻性聲明基於目前資訊及預期，且包含諸多風險與不確定性。由於各種因素，包括延遲採用新技術（無論是由於成本或效能問題抑或其他問題）或影響我們產品實現或使用的意外技術挑戰或限制，實際結果可能與此類聲明中的預計結果實質不同。

###